



2026年 8 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ド レ ッ ク ス
代表者名 代表取締役社長 松 村 米 浩
(コード番号：4586 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 藤 岡 健
経 営 管 理 部 長
(TEL. 03-3664-9665)

Bondlidoに関する特許査定(米国)のお知らせ

当社が出願中の「リドカイン含有貼付剤」について、USPTO（米国特許商標庁）より特許査定が通知されましたのでお知らせします。本特許は、帯状疱疹後の神経疼痛治療薬Bondlidoをカバーする特許の一つで、本製剤の均一性と安定性を実現する独自の製造プロセス技術を保護するものであり、有効期間は2040年迄です。本特許ファミリーは、日本、インド、カナダ、オーストラリア、韓国、ロシア、南アフリカ、メキシコにおいて登録査定を得ており、中国、欧州、ブラジル、サウジアラビアにおいても権利化を目指しています。

Bondlidoは、成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応として米国での販売承認を取得しているリドカインテープ剤です。米国におけるリドカイン貼付剤市場は、2025年において約440億円(295 million USドル、出所：IQVIA)と推計されています。Bondlidoは、これまでの臨床試験結果より、先行指標品であるLidodermより「皮膚刺激性が少なく」「貼付力に優れ」「運動時においても貼付力を保持できる」より良い製品として市場浸透することが期待されます。

本件による今期業績予想の変更はありませんが、中長期的な業績向上に資するものと考えます。

以 上